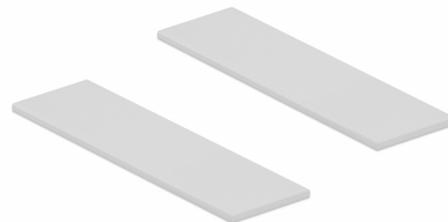


Delock Ensemble de patins thermiques (2 unités) 70 x 20 mm pour les modules M.2

Description

Ces patins thermiques autoadhésifs peuvent être utilisés pour dissiper la chaleur d'un module M.2. Ils peuvent être collés, par exemple, entre un M.2 SSD et un dissipateur de chaleur.



N° produit 18287

EAN: 4043619182879

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Patin thermique pour dissiper la chaleur
- Conductivité thermique : 3,2 W/mK
- Couleur : gris
- Dimensions (LxlxH) : env.
 - 1) 70 x 20 x 1,75 mm
 - 2) 70 x 20 x 0,75 mm

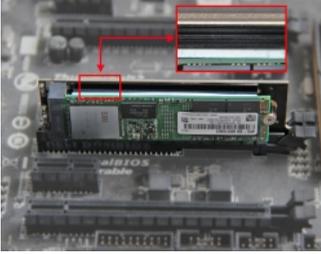
Configuration système requise

- Module M.2

Contenu de l'emballage

- 2 x supports thermiques

Image



Physical characteristics

| | |
|-----------|-------|
| Longueur: | 70 mm |
| Width: | 20 mm |